# SEMICONDUCTOR LASER

Patent number:

JP2001119096

Publication date:

2001-04-27

Inventor:

KURAMACHI TERUHIKO

Applicant:

**FUJI PHOTO FILM CO LTD** 

Classification:

- international:

H01S5/028

- european:

Application number:

JP19990295260 19991018

Priority number(s):

Also published as:

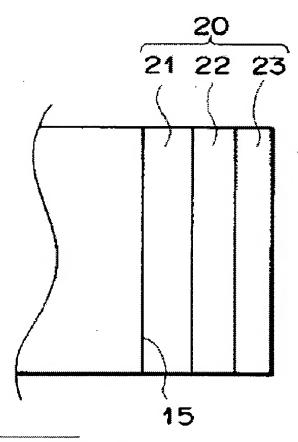


Report a data error hi

#### Abstract of JP2001119096

PROBLEM TO BE SOLVED: To restrict a refractive index and a reflection index change amount of an end surface to a change in the film thickness of a dielectric film formed on the element end surface, through which oscillation lights of a semiconductor laser pass, and accurately establish this reflection index as a desirable value.

SOLUTION: In a semiconductor laser, in which a dielectric film for controlling the reflection index of an end surface 15 is formed on at least the one element end surface 15 through which oscillation lights pass, as the dielectric film, three films of a first dielectric film 21 composed of Al2O3, a second dielectric film 22 composed of TiO2 or Ta2O5, and a third dielectric film 23 composed of SiO2 are formed in the order, from a side of the end surface 15. Oscillation wavelength is set at &lambda, and refractive indexes of the first dielectric film 21, second dielectric film 22 and third dielectric film 23 with respect to the wavelength &lambda are set as n1, n2 and n3, respectively and film thicknesses of the first dielectric film 21, second dielectric film 22 and third dielectric film 23 are set as d1, d2 and d3, respectively. Then, 0.09&lambda <=n1 d1<=0.15&lambda, 0.20&lambda <=n2 d2<=0.22&lambda, and 0.225&lambda <=n3 d3<=0.245&lambda.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開2001-119096 (P2001-119096A)(43)公開日 平成13年4月27日(2001.4.27)

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>

H 0 1 S

識別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

H 0 1 S 5/028 5F073

審査請求 未請求 請求項の数3

ΟL

(全6頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平11-295260

5/028

平成11年10月18日(1999.10.18)

(71)出願人 000005201

富士写真フィルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 蔵町 照彦

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富

士写真フィルム株式会社内

(74)代理人 100073184

弁理士 柳田 征史 (外1名)

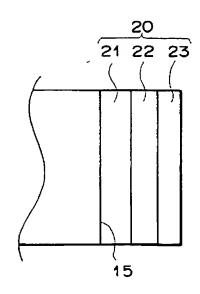
Fターム(参考) 5F073 AA83 CB20 DA33

# (54) 【発明の名称】半導体レーザー装置

#### (57)【要約】

【課題】 半導体レーザー装置の発振光が通過する素子 端面に形成する誘電体膜の屈折率および膜厚の変化に対 する該端面の反射率変化量を小さく抑えて、この反射率 を正確に所望値に設定する。

【解決手段】 発振光が通過する少なくとも一方の素子 端面15に、該端面15の反射率を制御する誘電体膜が形成 されてなる半導体レーザー装置において、前記誘電体膜 として、端面15側から順にA12 03 からなる第1誘電 体膜21、TiO<sub>2</sub> またはTa<sub>2</sub> O<sub>5</sub> からなる第2誘電体 膜22、およびSiO2からなる第3誘電体膜23の3層を 形成する。そして発振波長を入とし、この波長入に対す る第1誘電体膜21、第2誘電体膜22および第3誘電体膜 23の屈折率をそれぞれn1 、n2およびn3 とし、第1 誘電体膜21、第2誘電体膜22および第3誘電体膜23の膜 厚をそれぞれd1、d2、d3としたとき、0.09入≦n 1 d1  $\leq 0.15\lambda$ ,  $0.20\lambda \leq n2$  d2  $\leq 0.22\lambda$ ,  $0.225\lambda$ ≦n3 d3 ≦0.245入とする。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 発振光が通過する少なくとも一方の案子 端面に、該端面の反射率を制御する誘電体膜が形成され てなる半導体レーザー装置において、前記誘電体膜とし て、前記端面側から順に各々発振光に対して透明な第1 誘電体膜、第2誘電体膜、および第3誘電体膜の3層が 形成されており、発振波長を入とし、この波長入に対す る前記第1誘電体膜、第2誘電体膜および第3誘電体膜 の屈折率をそれぞれれ1、n2 およびn3 とし、前記第 1誘電体膜、第2誘電体膜および第3誘電体膜の膜厚を 10 それぞれd1、d2 およびd3 としたとき、

- $0.09\lambda \leq n1 d1 \leq 0.15\lambda$
- $0.20\lambda \le n2 d2 \le 0.22\lambda$
- $0.225\lambda \le n3$  d3  $\le 0.245\lambda$
- $1.58 \le n1 \le 1.64$
- $2.0 \le n2 \le 2.4$
- $1.44 \le n3 \le 1.46$

の関係が満たされていることを特徴とする半導体レーザ -装置。

【請求項2】 発振光が通過する少なくとも一方の素子 20 端面に、該端面の反射率を制御する誘電体膜が形成されてなる半導体レーザー装置において、前記誘電体膜として、前記端面側から順に $A1_2O_3$ からなる第1誘電体膜、 $TiO_2$ または $Ta_2O_5$ からなる第2誘電体膜、および $SiO_2$ からなる第3誘電体膜の3層が形成されており、発振波長を入とし、この波長入に対する前記第1誘電体膜、第2誘電体膜および第3誘電体膜の屈折率をそれぞれれ1、n2 およびn3 とし、前記第1誘電体膜、第2誘電体膜および第3誘電体膜の膜厚をそれぞれ d1、d2 およびd3 としたとき、 30

- $0.09\lambda \le n1 d1 \le 0.15\lambda$
- $0.20\lambda \leq n2 d2 \leq 0.22\lambda$
- $0.225\lambda \leq n3$  d3  $\leq 0.245\lambda$

の関係が満たされていることを特徴とする半導体レーザ 一装置。

【請求項3】 前記素子端面の反射率が10~25%の範囲 内にあることを特徴とする請求項1または2記載の半導 体レーザー装置。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体レーザー装置 に関し、特に詳細には、発振光が通過する素子端面の誘 電体膜が改良された半導体レーザー装置に関するもので ある。

#### [0002]

【従来の技術】半導体レーザー装置を、半導体結晶表面をむき出しのままにして動作させると半導体結晶表面が酸化され、半導体レーザー装置が徐々に劣化する。この問題を防止するために、例えば特開平6-112679号に示されているように、発振光が通過する半導体レー

ザー素子端面に、 $Al_2O_3$ (酸化アルミニウム)等からなる単層の透明な誘電体膜を形成した構成が知られている。

【0003】このような誘電体膜が形成された場合、索子端面の反射率は、誘電体膜の膜厚に応じて変化する。その反射率の変化特性の一例を図7に示す。そこで、この膜厚を制御することにより、索子端面の反射率を所望値に設定することも可能になる。なおこの図7では、横軸に膜厚そのものではなく、光学長(屈折率×膜厚)を、波長入に対する比で示してある。

【0004】従来知られている通り半導体レーザー装置にあっては、そこから出射した発振光が他の光学部品の端面等で反射して、いわゆる戻り光となって再入射すると、発振が不安定化してノイズが生じる等の問題を招く。この戻り光による問題を防止するためには、半導体レーザー装置の累子端面の反射率を10~25%程度に比較的低く設定しておくと効果的であり、そのようにするために、上述の誘電体膜の膜厚を制御する手法を適用することもできる。

#### 20 [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述のような 単層の誘電体膜を素子端面に形成する場合、図7からも 分かる通り、該端面の反射率は膜厚変化に対してかなり 急激に変化するので、この膜厚の制御によって素子端面 反射率を正確に所望値に設定することは非常に困難となっている。

【0006】一方図6の曲線bは、単層のA1203膜が形成された素子端面反射率の波長分散例を示すものである。図示の通りこの場合の素子端面反射率は、波長変30 化に対して非常に急激に変化する。半導体レーザー装置を生産する場合、例えば700~1100nm等のように、ある発振波長帯域にある半導体レーザー装置を共通の処理によって製造することも多いが、上記のように素子端面反射率の波長分散が大きいと、共通の処理によって製造できる半導体レーザー装置は、非常に狭い発振波長帯域のものに限られてしまう。

【0007】本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、発振光が通過する素子端面に形成する誘電体膜の屈折率および膜厚の変化に対する該端面の反射率変化 量を小さく抑えて、この反射率を正確に所望値に設定することができる半導体レーザー装置を提供することを目的とする。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明による1つの半導体レーザー装置は、前述したように発振光が通過する少なくとも一方の索子端面に、該端面の反射率を制御する誘電体膜が形成されてなる半導体レーザー装置において、前記誘電体膜として、前記端面側から順に各々発振光に対して透明な第1誘電体膜、第2誘電体膜、および50 第3誘電体膜の3層が形成されており、発振波長を入と

(3)

3

し、この波長入に対する前記第1誘電体膜、第2誘電体膜および第3誘電体膜の屈折率をそれぞれn1、n2 およびn3とし、前記第1誘電体膜、第2誘電体膜および第3誘電体膜の膜厚をそれぞれd1、d2 およびd3 としたとき、

 $0.09\lambda \le n1 d1 \le 0.15\lambda$ 

 $0.20\lambda \leq n2 d2 \leq 0.22\lambda$ 

 $0.225\lambda \leq n3$  d3  $\leq 0.245\lambda$ 

 $1.58 \le n1 \le 1.64$ 

 $2.0 \le n2 \le 2.4$ 

 $1.44 \le n3 \le 1.46$ 

の関係が満たされていることを特徴とするものである。 【0009】一般的な半導体レーザー発振光に対して透明な誘電体としては、例えば後述するA120。(酸化アルミニウム)、TiO2(酸化チタン)、Ta205(五酸化タンタル)およびSiO2(酸化シリコン)が知られている。上記の発明において誘電体膜材料はこれらに限定されるものではなく、A1およびOを含んで屈折率が1.58から1.64の範囲にある材料、TおよびOを含んで屈折率が2.2から2.4の範囲にある材料、TaおよびOを含んで屈折率が2.2から2.2の範囲にある材料、並びにSおよびOを含んで屈折率が1.44から1.46の範囲にある材料等を用いることもできる。

【0010】また本発明による別の半導体レーザー装置は、同じく発振光が通過する少なくとも一方の素子端面に、該端面の反射率を制御する誘電体膜が形成されてなる半導体レーザー装置において、前記誘電体膜として、前記端面側から順に各々A1 $_2$ 0 $_3$ (酸化アルミニウム)からなる第1誘電体膜、Ti0 $_2$ (酸化チタン)またはTa $_2$ 0 $_5$ (五酸化タンタル)からなる第2誘電体膜、およびSi0 $_2$ (酸化シリコン)からなる第3誘電体膜の3層が形成されており、発振波長を入とし、この波長入に対する前記第1誘電体膜、第2誘電体膜および第3誘電体膜の屈折率をそれぞれn1、n2 およびn3とし、前記第1誘電体膜、第2誘電体膜および第3誘電体膜の膜厚をそれぞれn1、n2 および第3誘電体膜の膜厚をそれぞれn1、n2 および

 $0.09\lambda \leq n1 d1 \leq 0.15\lambda$ 

 $0.20\lambda \leq n2 d2 \leq 0.22\lambda$ 

 $0.225\lambda \le n3$  d3  $\le 0.245\lambda$ 

の関係が満たされていることを特徴とするものである。 【0011】ここで、 $Al_2O_3$ の屈折率n1は1.58~1.64、 $TiO_2$ の屈折率n2は2.2~2.4、 $Ta_2O_5$ の屈折率n2は2.0~2.2、 $SiO_2$ の屈折率n3は1.44~1.46の範囲にそれぞれある。

【0012】なお以上の構成は、前述した戻り光対策のために、索子端面の反射率を10~25%程度に比較的低く設定する場合に適用すると特に効果的である。

[0013]

【発明の効果】誘電体膜の屈折率および膜厚の変化に対 50 = (入+6入)/4の関係から、上記3層の誘電体膜を

する累子端面の反射率変化量を小さくすることは、下記の理由により、波長による反射率分布を小さくすることと等価となる。このことから、波長変化に対する反射率変化の小さい層構成の誘電体膜を端面に形成すれば、本発明の目的が達成されることになる。

【0014】単層の誘電体膜の屈折率nおよび膜厚dと、反射率が最低になる光の波長入との間には、nd= 入/4の関係があるので、屈折率nおよび膜厚dのバラッキ量をそれぞれるn、δdとし、波長入の変化量をδ10 入とすると、

 $(n+\delta n)$   $(d+\delta d)=(\lambda+\delta\lambda)/4$  の関係が成り立つ。このことから、波長入と波長  $(\lambda+\delta\lambda)$  での反射率がほぼ同等となるような層構成の誘電体膜を形成すれば、屈折率および膜厚のバラッキ $\delta n$ 、 $\delta d$ の範囲内で、ほぼ同等の反射率を得ることができる。そこで、波長変化に対する反射率分布の小さい層構成の誘電体膜を端面に形成すればよいことになる。

【0015】上述した

 $0.09\lambda \le n1 d1 \le 0.15\lambda$ 

 $0.20\lambda \le n2 d2 \le 0.22\lambda$ 

 $0.225\lambda \le n3$  d3  $\le 0.245\lambda$ 

の関係を満足する、 $Al_2O_3$ からなる第1誘電体膜、 $TiO_2$ あるいは $Ta_2O_5$ からなる第2誘電体膜、および $SiO_2$ からなる第3誘電体膜の3層構成の誘電体膜は、具体的に図6の曲線aで例示するように、従来用いられて来た単層の誘電体膜(曲線b)と比べて明らかに、波長変化に対する反射率変化が小さいものである。

【0016】なお、第1誘電体膜、第2誘電体膜、および第3誘電体膜の材料を規定しない請求項1の構成でも、それら第1誘電体膜、第2誘電体膜、および第3誘電体膜の屈折率範囲はそれぞれ、 $A1_2O_3$ の屈折率範囲 $1.58\sim1.64$ 、 $TiO_2$  あるいは $Ta_2O_5$  の屈折率範囲 $2.0\sim2.4$ 、 $SiO_2$  の屈折率範囲 $1.44\sim1.46$ と同じとされているから、上記と同様の効果を得ることができる。

【0017】したがって、このような3層構成の誘電体膜を素子端面に有する本発明の半導体レーザー装置は、誘電体膜の屈折率および膜厚の変化に対する該端面の反射率変化量を小さく抑えて、この反射率を正確に所望値に、すなわち例えば戻り光対策の要求に基づく10~25%の範囲内の値に設定可能なものとなる。

【0018】より具体的には後述する通り、発振波長が ±150nm程度異なっても、10~25%の範囲内の反射率 を±1.5%(余裕を見ても2%程度)の誤差範囲で所望 値に設定することができる。したがって、本発明による 半導体レーザー装置は、発振波長が300nm程度異なる ものでも共通の端面コート処理によって製造可能とな り、生産性を大幅に向上させることができる。

【0019】また、前述した(n+ゟn)(d+ゟd) =(入+ゟ入)/4の関係から、上記3層の誘電体膜を

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。図1は、本発明の第1の実 10 施形態による半導体レーザー装置を示すものである。この半導体レーザー装置は、例えばG a A s x s

【0021】そして共振器面を構成する素子の前端面15 および後端面16にはそれぞれ、前述したように該端面の酸化を防止するとともに、端面反射率を制御するための 20 誘電体多層膜20、30が形成されている。本実施形態において、後端面16の誘電体多層膜30は高反射率が得られる多層膜とされ、一方、戻り光が入射する可能性が有る前端面15の誘電体多層膜20は、反射率を10~25%の範囲内の値(具体的に本例では13%)に設定し得る3層の誘電体膜とされている。

【0022】なお、本発明は必ずしも前端面15の誘電体膜に適用されるものではなく、後端面16の反射率を比較的低く設定する要求が有る場合は、勿論、この後端面16の誘電体膜を本発明による3層構造としてもよいし、さらには、単層の誘電体膜としてもよい。

【0023】この第1実施形態においては、発振波長入=800nmに対して、前端面15の反射率を13%に設定するものであり、そのための誘電体多層膜20は図2に示すように、前端面15の上に形成されたA1 $_2$ 0 $_3$ からなる第1誘電体膜21と、その上に形成されたT iO2 $_2$ からなる第2誘電体膜22と、さらにその上に形成されたS iO2 $_2$ からなる第3誘電体膜23とによる3 層構成とされている。

【0024】そして第1誘電体膜21、第2誘電体膜22、および第3誘電体膜23の屈折率をそれぞれれ1、n2 およびn3 とし、膜厚をそれぞれd1、d2 およびd3 としたとき、n1 d1 =0.095、n2 d2 =0.20人、n3 d3 =0.235となっている。ただしこの場合、A  $1_2$  O 3 の屈折率n1 =1.60、T i O2 の屈折率n2 =2.25、S i O2 の屈折率n3 =1.45、半導体レーザー案子自身の屈折率n33.4とする。

【0025】この構成における前端面15の反射率の波長 分散特性は、図3に示すものとなる。ここに図示されて いる通り、設計波長入=800nmに対して±150nmの範 50

囲内で、前端面15の反射率を13±1.5%に設定することができる。

【0026】なお本例において第1誘電体膜21、第2誘電体膜22、および第3誘電体膜23は、真空蒸着によって形成したが、それに限らずスパッタ法や気相堆積法(CVD)等を適用しても構わない。

【0027】次に、本発明の第2の実施形態による半導体レーザー装置について説明する。なおこの第2実施形態の半導体レーザー装置は、基本的な形状は第1実施形態のものと同等であるので、図1および図2を参照して説明する(後の第3実施形態についても同様)。

【0028】この第2実施形態においては、発振波長入 $=800\,\mathrm{n}\,\mathrm{m}$ に対して、前端面15の反射率を16%に設定するものであり、そのための誘電体多層膜20は図2に示すように、前端面15の上に形成された $\mathrm{Al_2O_3}$ からなる第1誘電体膜21と、その上に形成された $\mathrm{TiO_2}$ からなる第2誘電体膜22と、さらにその上に形成された $\mathrm{SiO_2}$ からなる第3誘電体膜23とによる3層構成とされている。

【0029】そして第1誘電体膜21、第2誘電体膜22、 および第3誘電体膜23の屈折率をそれぞれn1、n2 お よびn3 とし、膜厚をそれぞれd1、d2 およびd3 と したとき、n1 d1 =0.12、n2 d2 =0.20 $\lambda$ 、n3 d3 =0.235となっている。ただしこの場合、A  $1_2$   $O_3$ の屈折率n1 =1.60、T i  $O_2$  の屈折率n2 =2.25、Si  $O_2$  の屈折率n3 =1.45、半導体レーザー素子自身の 屈折率n=3.4とする。

【0030】この構成における前端面15の反射率の波長 分散特性は、図4に示すものとなる。ここに図示されて 30 いる通り、設計波長入=800nmに対して±150nmの範 囲内で、前端面15の反射率を16±1.5%に設定すること ができる。

【0031】次に、本発明の第3の実施形態による半導体レーザー装置について説明する。この第3実施形態においては、発振波長 $\lambda$ =800nmに対して、前端面15の反射率を20%に設定するものであり、そのための誘電体多層膜20は図2に示すように、前端面15の上に形成されたA1 $_2$ 0 $_3$ からなる第1誘電体膜21と、その上に形成されたTi0 $_2$ からなる第2誘電体膜22と、さらにその上に形成されたSi0 $_2$ からなる第3誘電体膜23とによる3層構成とされている。

【0032】そして第1誘電体膜21、第2誘電体膜22、および第3誘電体膜23の屈折率をそれぞれn1、n2 およびn3 とし、膜厚をそれぞれd1、d2 およびd3 としたとき、n1 d1 =0.145、n2 d2 =0.20 $\lambda$ 、n3 d3 =0.235となっている。ただしこの場合も、 $A1_2$  O<sub>3</sub> の屈折率n1 =1.60、 $TiO_2$  の屈折率n2 =2.2 5、 $SiO_2$  の屈折率n3 =1.45、半導体レーザー案子自身の屈折率n3=3.4とする。

【0033】この構成における前端面15の反射率の波長

7

分散特性は、図5に示すものとなる。ここに図示されている通り、設計波長 $\lambda=800$ nmに対して $\pm150$ nmの範囲内で、前端面15の反射率を $20\pm1.5\%$ に設定することができる。

【0034】なお以上説明した3つの実施形態においては、第2誘電体膜22をTiO2から形成しているが、第2誘電体膜をTa2O5から形成しても構わない。また以上の実施形態では、素子前端面15の上に直接第1誘電体膜21を形成しているが、素子前端面15の上に別の薄膜を形成して、その上に第1誘電体膜21を形成するように1011してもよい。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態による半導体レーザー装置を示す斜視図

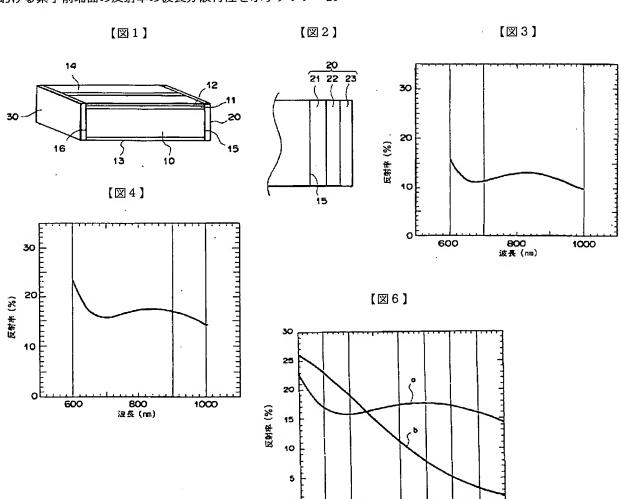
【図2】上記半導体レーザー装置の要部を拡大して示す 側面図

【図3】上記第1実施形態の半導体レーザー装置における素子前端面の反射率の波長分散特性を示すグラフ

【図4】本発明の第2実施形態の半導体レーザー装置に おける累子前端面の反射率の波長分散特性を示すグラフ 20 【図5】本発明の第3実施形態の半導体レーザー装置における累子前端面の反射率の波長分散特性を示すグラフ【図6】本発明の半導体レーザー装置と従来装置における累子端面反射率の波長分散特性を比較して示すグラフ【図7】従来の半導体レーザー装置における誘電体膜の膜厚変化に対する累子端面反射率の変化特性を示すグラフ

# 【符号の説明】

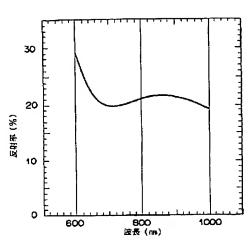
- 10 基板
- 11 エピタキシャル多層膜
- 12 電流狭窄層
- 13 N電極
- 14 P電極
- 15 素子前端面
- 16 索子後端面
- 20、30 誘電体多層膜
- 21 第1誘電体膜
- 22 第2誘電体膜
- 23 第3誘電体膜



700

波長 (mm)

【図5】



[図7]

